

1.5 新封装技术举例

今天，新型封装技术的主要发展方向如下：

1. 散热能力和温度循环能力的改善；
2. 通过合理的结构设计，降低模块内部的电感以及引线的电感；
3. 高度灵活的封装与连接技术，简化用户方的装配；
4. 更高的复杂度与集成度（完整的变流电路）；
5. 集监视、保护和驱动功能为一体；
6. 提供测试过的电气或电热系统。

下面举例所述的四种功率模块系列就是依据上述考虑和要求而开发的。